附件三

**114學年度半導體學士後專班招生-香港或澳門學歷切結書**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 准考證號 | (考生勿填) | 考生簽章 |  |
| 身分證字號 |  | 聯絡電話 | 住家：( )行動： |
| E-mail |  |
| 通訊地址 |  |

**【請將本切結書，連同經由驗證之證明文件，於報名時一併上傳】**

　　本人報考義守大學114學年度半導體學士後專班入學招生，所持香港或澳門學歷證件確為教育部認可，請准予上傳下列證明文件報考，並保證於錄取報到時，繳交下列正本資料：

1. 經行政院在香港或澳門設立或指定機構或委託之民間團體驗印之學歷證件(外文應附中譯本)。
2. 經行政院在香港或澳門設立或指定機構或委託之民間團體驗印之歷年成績證明(外文應附中譯本)。
3. 身分證明文件影本及修業起訖期間之香港或澳門主管機關核發之出入境紀錄證明。但申請人為香港或澳門永久居民者，免附出入境紀錄證明。
4. 其他相關文件。

**本人同意於錄取報到時繳交上列學歷正本，所附各項文件如經貴校查驗、查證為不符合「香港澳門學歷檢覈採認辦法」規定，則取消錄取資格(已入學者開除學籍)，亦不發給任何學歷證件，絕無異議，特此聲明。**

|  |  |
| --- | --- |
| 地 區 |  🞎 香港 🞎 澳門 |
| 就讀學校中文名稱 |  |
| 就讀學系之中文名稱 |  |
| 就讀學校就讀期間 |  年 月至 年 月 合計 年 個月 |

此致

 義守大學招生委員會

中 華 民 國 年 　 月 日